

Cutting Edge

第67期中間事業報告書

平成17年4月1日～平成17年9月30日

証券コード：6146



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



DISCO VALUESを 感じてください。

p3 — 特集：DISCOの事業とは？

p5 — DISCO News

DISCO Story……………①

砥石から万年筆のペン先に見た未来

p14 — 起業の原点に「ものづくりへの情熱」あり。

Financial Highlights

財務ハイライト

◎売上高（連結）

288億68百万円

好調な携帯電話・PC市場を背景に、半導体メーカーの設備投資が回復しました。これに伴い半導体製造装置受注も回復、当社においては第2四半期から回復しましたが、好調であった前年同期と比較すると18.7%減の売上高となりました。

◎経常利益（連結）

48億28百万円

前年同期比31億65百万円(39.6%減)の減益となりました。しかし前年下期比較では28億15百万円の増加となり、経常利益率は8.1%から16.7%と8.6%改善しました。売上高増加に加え、高付加価値製品である新機種比率上昇に伴い精密加工装置の利益率が向上したためです。

◎中間純利益（連結）

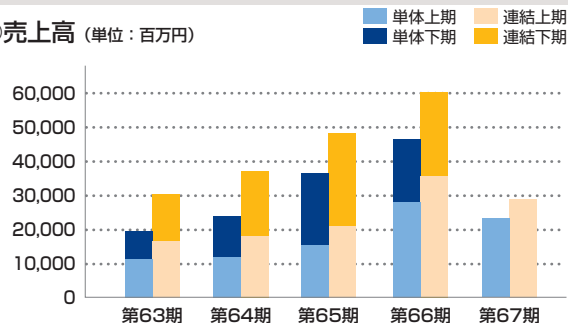
22億95百万円

前年同期比21億86百万円(48.8%減)の減益となりました。純利益率は12.6%から8.0%と4.6%低下しましたが、前年下期比では4.7%の上昇となりました。

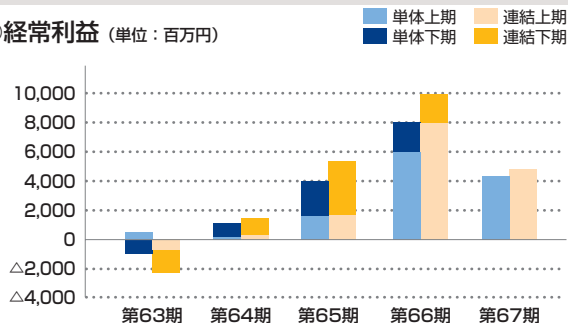
免責条項

業績予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありますのでご承知おさください。

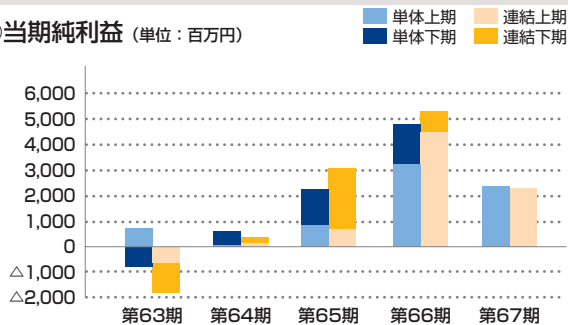
◎売上高（単位：百万円）



◎経常利益（単位：百万円）



◎当期純利益（単位：百万円）



To Our Shareholders

株主の皆様へ

ディスコの「あるべき姿」を追求しつつ安定と成長の両立を実現します。

当中間期の経営環境と業績

当中間期は、原油価格の高騰に伴うインフレ懸念はあったものの、世界経済は安定的な成長基調を迎えました。半導体市場はシリコンサイクルのピークの翌年のため、市場が冷え込むリスクがありましたが、早期の生産調整が実施され、調整局面は今第1四半期にほぼ終了いたしました。また半導体の中心的な用途であるパソコン・携帯電話といった最終製品の需要が先進国に加えて中国をはじめとする経済新興国(BRICs)でも大きく伸張したことなどにより、特に海外半導体メーカーの稼働率が上昇し設備投資が回復したため、半導体製造装置受注もあわせて回復してまいりました。

当社はこのような市場環境の中、市場機会を捉えた積極的な販売活動・顧客価値向上活動に取り組み、好調であった前年上期の業績には届かないものの、対前年下期比では増収増益となりました。下期の見通しといたしましては、最終製品市場での調整等のリスクはありますが、今第2四半期からの回復傾向が継続するものと見込んでおります。

ディスコビジョンの実現に向けて

当社は2010年時点でのビジョンとして掲げた自分たちの「あるべき姿」の実現に向けて、あらゆる業務の効率化、収益の安定化を可能にする精密加工ツールの売上拡大といった施策を推進しております。また競争力の源泉である研究開発においては、成長市場であるレーザーによる精密切断技術や薄化・ストレスリリーフ技術などお客様のニーズに応える革新的な技術を創造



代表取締役会長
関家 憲一

代表取締役社長
溝呂木 斉

するため、今後とも先進的な取り組みを進めてまいります。

株主還元について

株主様に対する利益還元は、最重要政策のひとつとして位置付けておりますが、1株当たり利益を向上させつつ業績に裏付けられた成果の配分を行うという観点から、中間配当金につきましては、1株につき15円とさせていただきます。

株主の皆様におかれましては、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2005年12月

代表取締役会長 関家 憲一

代表取締役社長

DISCO Feature

特集：DISCOの事業とは？

Kiru・Kezuru・Migaku ならディスコ



※白抜きはディスコの装置

年間生産量4,000億個以上。毎年7%以上の成長。半導体は、現代IT社会の原動力となっているパソコンをはじめとして、年間7億台出荷とも言われる携帯電話、デジカメ・DVDレコーダー・薄型テレビといったデジタル家電にも搭載され、拡大・成長を続けています。

ディスコは、半導体製造においてウエーハの表面・裏面を平坦に研削・研磨する（グライディング）工程、電子回路の形成されたウエーハやパッケージをチップに切り分けるダイシング工程に用いられる装置、そして「刃」として使用される精密加工ツールの両方を提供している世界で唯一の会社です。高度な「Kiru(切る)・Kezuru(削る)・Migaku(磨く)」技術に特化して、ミクロン(1ミリの1,000分の1)レベルの超精密加工の技術革新を担っています。半導体に用いられるシリコンだけでなく、多様な素材で構成される電子部品・光部品などの加工にも私たちの技術が活かされています。

お客様の求める加工結果を実現するため、精密加工装置、精密加工ツールだけでなく、最適な加工方法(アプリケーション)を融合させて付加価値の高いソリューションを提供しています。また、世界中にいるお客様の近くできめ細かい対応ができるよう世界各地にサポート拠点を構築しています。

お客様に本質的な満足を提供し「Kiru・Kezuru・Migakuならディスコ」と相談していただく存在であり続けるために、ディスコは進化を続けていきます。



DISCO Products & Service

精密加工ツール

精密ダイヤモンド砥石に代表される精密加工ツールは、シリコンウェーハやセラミックスなどを「Kiru(切る)」ダイシングブレード、「Kezuru(削る)」グラインディングホイール、「Migaku(磨く)」ドライポリッシングホイールなどに大別されます。創業以来培ってきたノウハウを最大限活かし、多様なお客様のニーズに応える製品の開発・製造を行っています。



- ・ダイシングブレード
- ・グラインディングホイール
- ・ドライポリッシングホイール

精密加工装置

精密加工ツールを用いて、半導体・電子部品の精密切断に用いる「ダイシングソー」、シリコンウェーハなどの平坦研削、研磨を行う「グラインダ」「ポリッシャ」、通常のブレードダイシングでは加工の難しい素材の切断を可能にする「レーザーソー」をはじめとして、お客様の「Kiru・Kezuru・Migaku」ニーズに合わせたセミオーダーメイド装置の提供を行っています。



- ・ダイシングソー
- ・レーザーソー
- ・グラインダ
- ・グラインダ/ポリッシャ

アプリケーション

「Kiru・Kezuru・Migaku」技術に関わる、あらゆるお客様の多様な加工ニーズに対応するためのアプリケーション(応用技術)こそがディスコの強みです。当社では、上述の精密加工ツール・精密加工装置に加えて、最適な加工結果を得るための当社独自のアプリケーション技術でお客様をサポートしています。



今期のDISCOを振り返ります。

Management



顧客満足度調査で 第2位を受賞

当社は2005年6月、米国VLSI Research Inc. (※1) が実施する「VLSI 10 Best Award 2005」においてアSEMBリー(組立て)部門で第2位を受賞しました。この賞は半導体製造装置メーカーに関する顧客満足度調査(※2)結果に対して贈られるものです。当社の同賞受賞は1996年より11年連続となります。

当社は今後も更なる「お客様満足」向上を目指し、組織的な活動を強力に推進していきます。

Note :

※1 VLSI Research Inc.(本社・米国カリフォルニア州)は、半導体製造装置産業の調査・コンサルティング会社で、20年の歴史をもつ「VLSI 10 Best Award」は半導体業界唯一の顧客満足度調査として広く認知されています。

VLSI Research Inc.→ <https://www.vlsiresearch.com>

※2 この調査は世界の約46,000件に及ぶ半導体デバイスメーカーのプロセス技術者を調査対象とした装置メーカーの装置別満足度調査です。

Business

精密加工ツール過去最高売上

当中間期は、パソコン・携帯電話など最終製品需要の高まりにより、半導体生産も好調に推移しました。こうした市場環境に伴い、当社は過去最高の精密加工ツール売上を計上。今後も、短期的にはシクリカル(循環型)な市場動向の影響により売上が増減することが予想されますが、中長期的には半導体生産量の伸長が確実視されており、精密加工ツール売上も着実に伸びていくものと予測しています。

◎精密加工ツール四半期売上高推移 指数 90年度四半期平均=100



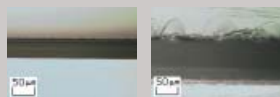
Technology

超音波による ダイシングアプリケーション

オートマチックダイシングソーは、半導体ウェーハの切断だけでなく、電子部品や光部品などのシリコンとは異なる素材の加工にも用いられるようになっていきます。新たに開発した超音波振動スピンドルを搭載することにより、これまで加工が難しかった石英、水晶、アルミナなどの被加工物が高精度・スピーディに切断可能になりました。さらにブレードライフ・加工スピードの向上が図れます。

◎切断加工写真

超音波振動なし



0.9mm/秒

1mm/秒

1mm/秒に加工スピードを上げると精度が落ちてしまう

超音波振動あり



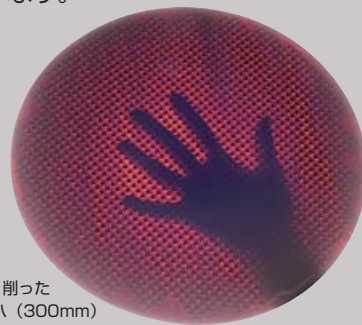
1mm/秒

6mm/秒

6mm/秒に上げてても高精度に加工できる

5ミクロン仕上げウェーハ

当社は本年5月、透けて見えるほど薄い5 μ m厚の極薄ウェーハの研削・研磨技術を実現しました。現在、最先端半導体デバイスに使用されるICチップの厚さは75 μ m程度ですが、今後、更に薄いチップ・ウェーハへのニーズが高まると予想されます。5 μ m厚のウェーハがただちに最新の半導体に用いられることはありませんが、当社では将来の技術トレンドを見据えた先行的な研究開発活動を行っています。



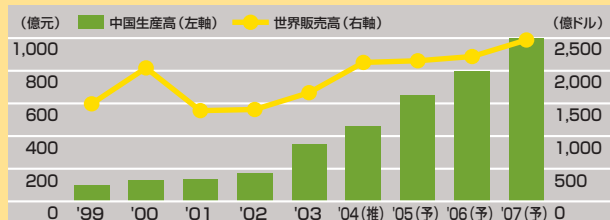
5 μ mまで薄く削った
半導体ウェーハ (300mm)



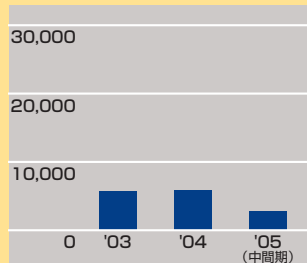
急ピッチで拡大する 中国の半導体生産

先進国を中心に高い成長率で発展してきた半導体産業ですが、中国においてもいよいよ半導体生産が本格化してきました。中国の半導体生産高は2002年以来、急ピッチで伸びており、2004年から2007年の年平均成長率も世界平均の5.1%を大幅に上回る29.5%という驚異的な急成長をみせるものと予測されています。

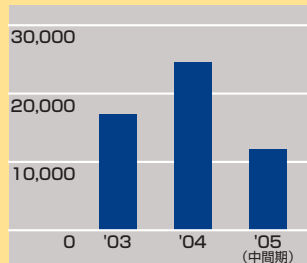
◎半導体生産高の年平均成長率 [出典：半導体産業新聞、WSTS]



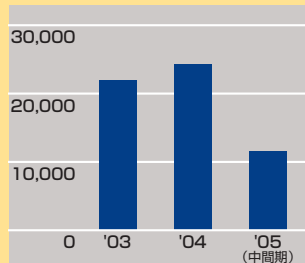
◎地域別売上高推移 単位(百万円)



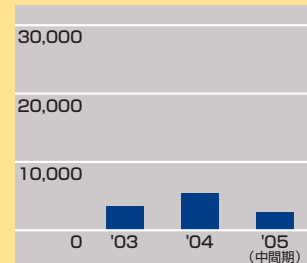
【欧州】



【アジア】



【日本】



【北米】

半導体メーカーの中国シフトに 合わせて事業拠点を拡大

昨今、中国における半導体・電子部品製造産業は目覚ましい成長を遂げています。ディスコでは、半導体メーカーの中国生産シフトに合わせて、中国での事業拠点網拡大を加速しています。既存の上海、天津、広東に加え、2005年5月には蘇州・成都にもサービス拠点を設立し、現地従業員数も2001年3月時点から4倍に増員するなど、お客様へのサービスの拡充を進めています。

上海にあるDISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.





次世代SiP技術の 主役を担うディスコ

「自分や人の居場所がわかる」「音楽が聴ける」「飲み物が買える」「テレビが見られる」携帯電話、「小さくて薄い」デジタルカメラ、「何百枚もの写真が保存できる」メモリーカード、「偽造や不正引き出しを防ぐ」キャッシュカード、「買い物ができる」定期券。これらに共通するのは高性能な半導体が搭載されていることです。

近い将来、携帯電話は「テレビ番組を録画予約する」「冷蔵庫の中身をチェックして買い物をする」といった高機能化が当たり前ものになるでしょう。保存容量の大きなメモリー（記憶媒体）は、パソコンや携帯電話の更なる小型化・省電力化に欠かせません。さらにIC搭載カードやICタグは、安全・安心な暮らしを守る上で更なる普及が見込まれています。

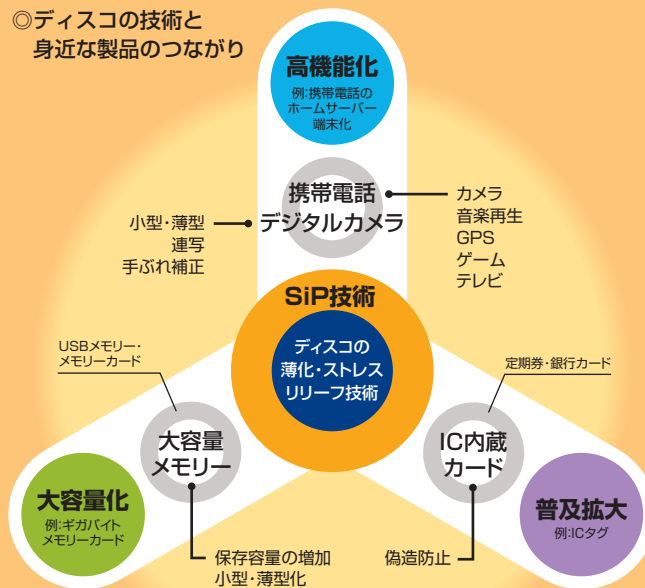
このような快適な社会生活の実現を支える半導体の革新製造技術として、現在SiP (System in Package) 技術が注目されています。SiPとは、一枚一枚の半導体チップを薄くし、何枚も積層し、ひとつにパッケージとすることで、高機能・大容量なデバイスを製造する技術です。ディスコは、SiP技術に不可欠な「薄化・ストレスリリーフ」技術を提供しています。ディスコは、半導体チップやウェーハを紙よりも薄く削る「薄化」技術、さらに割れやそりをなくし強度の高いチップを作成す



薄化・ストレス
リリーフ工程

る「ストレスリリーフ」技術も幅広く備えています。『高度な「Kiru・Kezuru・Migaku」ならディスコ』というお客様の信頼に応えるために、幅広いソリューションラインナップで、デジタル機器の更なる高性能化を実現します。

◎ディスコの技術と 身近な製品のつながり



DISCO VALUES



DISCO VALUESを 感じてください。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」この一文はディスコの企業価値観であるDISCO VALUESに記載されているもので、当社の現在及び将来において果たすべき社会的役割を端的に表したものです。

ディスコは60余年の歴史の中で、事業規模・組織規模を拡大してきました。安定した成長を遂げてきたようにも見えますが、組織の拡大はセクショナリズムに代表される大企業病リスクを呼び込む恐れがあります。

また当社が主に事業を展開している半導体業界は、市場の特徴としてシリコンサイクルと呼ばれる大きな需給の波があり、企業として短期的な利益を追い求めるだけのビジネスモデルを

追求しては長期にわたる成長を阻害することになります。

このようなリスクを回避し、更なる成長を遂げていくためには長期的視点に立った企業としての確固たる価値観、そしてこれに基づく良質な企業文化を醸成することが必要であると考えます。

当社が1997年に纏め上げたDISCO VALUESには、ディスコの社会的役割、組織としてのあり方などディスコ構成員に求められる考え方・判断基準が明確に示されています。

揺るがぬ価値観に支えられた組織は良質な企業文化を形成し、良質な企業文化は組織の成長の礎となります。

我々は事業面での成長を促進するためにも、決して現状に満足せず良質な企業文化を醸成していきます。



Financial Data

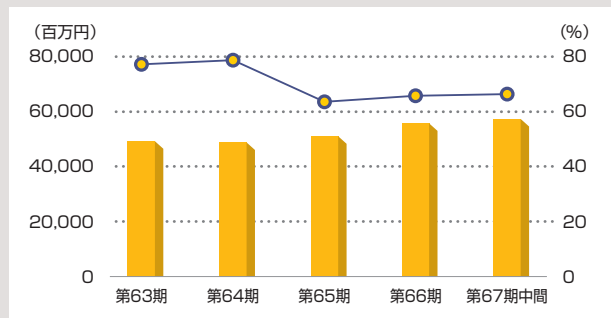
財務指標

◎1株当たり中間純利益



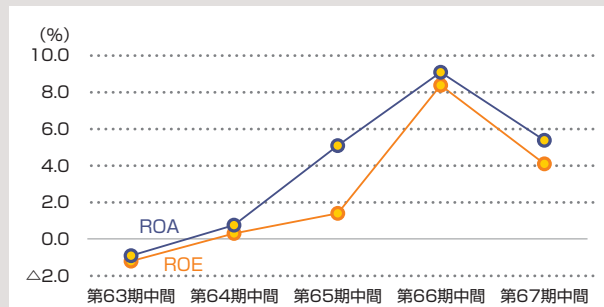
前年同期比で中間純利益が減少したことから、1株当たり中間純利益は71.33円と前年同期比68.15円の減少となりました。

◎株主資本・株主資本比率



株主資本は、前期末比15億67百万円の増加となりました。さらに、分母である総資産が減少したため、株主資本比率は前期末の65.7%から66.3%と0.6ポイント上昇しました。

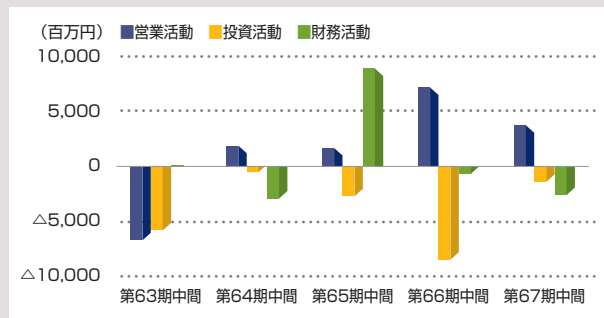
◎ROA・ROE



ROAは、分母である総資産が前年同期比で減少し、分子である営業利益も減少したため、5.4%と前年同期比3.7ポイント低下しました。

ROEは、株主資本が増加し中間純利益が減少したため、4.1%と前年同期比4.3ポイント低下しました。

◎キャッシュ・フロー



営業活動の結果得られた資金は、37億34百万円(前年同期比34億46百万円減)となりました。

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得を主因として14億円(同70億83百万円減)となりました。

財務活動の結果使用した資金は、長期借入金返済と配当金支払いを主因として26億1百万円(同19億17百万円増)となりました。

Financial Statements

財務諸表

中間連結貸借対照表

(単位: 百万円)

科目	第66期中間期	第67期中間期	第66期通期
	平成16年 9月30日現在	平成17年 9月30日現在	平成17年 3月31日現在
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	17,121	16,728	16,891
受取手形及び売掛金	20,877	19,134	16,421
棚卸資産	15,401	14,982	15,005
繰延税金資産	1,082	971	981
その他	1,207	1,238	1,245
貸倒引当金	△15	△34	△28
流動資産合計	55,675	53,020	50,517
固定資産			
有形固定資産			
建物及び構築物	8,264	11,653	11,705
機械装置及び運搬具	3,551	4,051	4,096
土地	13,787	12,197	12,507
建設仮勘定	4,135	436	513
その他	521	581	583
有形固定資産合計	30,261	28,921	29,406
無形固定資産			
投資その他の資産	794	380	412
投資有価証券	1,630	1,465	1,724
繰延税金資産	2,419	1,907	1,930
その他	1,102	872	948
貸倒引当金	△76	△94	△100
投資その他の資産合計	5,075	4,151	4,502
固定資産合計	36,131	33,452	34,321
資産合計	91,806	86,473	84,839
(負債の部)			
流動負債			
支払手形及び買掛金	8,715	6,985	5,159
短期借入金	934	594	624
一年以内返済予定の長期借入金	885	-	440
未払法人税等	3,433	2,306	2,790
賞与引当金	2,027	1,758	1,385
製品保証引当金	291	161	198
その他	5,854	4,436	4,368
流動負債合計	22,141	16,244	14,966
固定負債			
新株予約権付社債	9,000	9,000	9,000
長期借入金	2,200	700	1,980
長期未払金	1,040	985	1,042
退職給付引当金	1,739	1,750	1,736
その他	68	169	84
固定負債合計	14,049	12,606	13,843
負債合計	36,191	28,850	28,809
(少数株主持分)			
少数株主持分	281	328	302
(資本の部)			
資本金	9,842	9,885	9,885
資本剰余金	10,715	10,967	10,967
利益剰余金	34,918	36,450	35,024
その他有価証券評価差額金	102	200	137
為替換算調整勘定	△223	△178	△259
自己株式	△21	△31	△29
資本合計	55,333	57,294	55,726
負債、少数株主持分及び資本合計	91,806	86,473	84,839

中間連結損益計算書

(単位: 百万円)

科目	第66期中間期	第67期中間期	第66期通期
	(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
売上高	35,513	28,868	60,320
売上原価	17,327	13,943	29,740
販売費及び一般管理費	10,394	10,333	20,710
営業利益	7,791	4,591	9,869
営業外収益	308	322	457
受取利息及び配当金	15	32	34
受取手数料	27	11	42
為替差益	184	203	28
持分法による投資利益	13	-	7
その他	67	75	344
営業外費用	106	85	319
支払利息	20	12	39
売上割引	33	11	47
持分法による投資損失	-	9	-
その他	51	52	232
経常利益	7,993	4,828	10,006
特別利益	44	0	377
固定資産売却益	0	0	268
その他	44	-	108
特別損失	774	802	1,303
固定資産除売却損	64	38	345
投資有価証券評価損	381	21	381
連結調整勘定減損処理額	-	357	-
役員特別功労金	181	-	181
特別退職加算金	100	23	118
減損損失	-	313	-
その他	46	48	276
税金等調整前中間(当期)純利益	7,263	4,027	9,080
法人税、住民税及び事業税	3,113	1,801	3,476
法人税等調整額	△419	△86	188
少数株主利益	88	16	114
中間(当期)純利益	4,481	2,295	5,301

中間連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(単位: 百万円)

科目	第66期中間期	第67期中間期	第66期通期
	(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)	(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	7,180	3,734	7,281
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,484	△1,400	△7,432
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△684	△2,601	△2,056
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	78	104	68
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	△1,909	△163	△2,139
VI 現金及び現金同等物の期首残高	19,031	16,891	19,031
VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	17,121	16,728	16,891

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第66期中間期	第67期中間期	第66期通期
	平成16年 9月30日現在	平成17年 9月30日現在	平成17年 3月31日現在
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	13,388	13,141	14,177
受取手形	1,092	1,544	1,342
売掛金	15,655	14,228	10,832
棚卸資産	13,412	13,041	13,301
繰延税金資産	1,147	1,091	1,134
その他	2,517	1,266	2,487
貸倒引当金	△1	△1	△1
流動資産合計	47,212	44,311	43,274
固定資産			
有形固定資産			
建物	6,717	10,061	10,109
土地	13,050	11,644	11,956
建設仮勘定	4,135	415	513
その他	3,870	4,447	4,569
有形固定資産合計	27,773	26,569	27,149
無形固定資産	546	158	173
投資その他の資産			
投資有価証券	993	836	1,073
関係会社株式	4,213	3,905	3,760
繰延税金資産	1,909	2,094	1,914
その他	1,195	1,891	946
貸倒引当金	△60	△71	△60
投資その他の資産合計	8,251	8,657	7,634
固定資産合計	36,571	35,384	34,956
資産合計	83,784	79,696	78,231
(負債の部)			
流動負債			
支払手形	3,508	2,625	1,952
買掛金	4,370	3,262	2,161
短期借入金	400	-	-
一年以内返済予定の長期借入金	440	-	440
一年以内償還予定の新株引受権付社債	312	-	-
未払法人税等	2,950	1,743	2,349
賞与引当金	1,766	1,603	1,218
その他	5,269	4,054	4,010
流動負債合計	19,017	13,288	12,133
固定負債			
新株予約権付社債	9,000	9,000	9,000
長期借入金	1,500	-	1,280
長期未払金	1,040	983	1,040
退職給付引当金	1,518	1,653	1,642
長期預り保証金	-	78	-
固定負債合計	13,059	11,715	12,963
負債合計	32,077	25,003	25,096
(資本の部)			
資本金	9,842	9,885	9,885
資本剰余金			
資本準備金	10,715	10,967	10,967
資本剰余金合計	10,715	10,967	10,967
利益剰余金			
利益準備金	594	594	594
任意積立金	17,024	17,020	17,024
中間(当期)未処分利益	13,450	16,054	14,554
利益剰余金合計	31,069	33,670	32,173
其他有価証券評価差額金	102	200	137
自己株式	△21	△31	△29
資本合計	51,707	54,692	53,134
負債及び資本合計	83,784	79,696	78,231

中間損益計算書

(単位：百万円)

科目	第66期中間期	第67期中間期	第66期通期
	自平成16年4月1日 至平成16年9月30日	自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
売上高	28,085	23,161	46,480
売上原価	13,855	11,564	23,098
販売費及び一般管理費	8,608	8,357	16,949
営業利益	5,621	3,239	6,432
営業外収益	392	1,115	1,842
受取利息及び配当金	51	886	1,333
受取賃貸料	82	40	133
為替差益	225	150	103
その他	32	38	272
営業外費用	38	15	191
支払利息	12	0	23
売上割引	16	1	17
貸倒引当金繰入額	-	11	-
その他	10	1	149
経常利益	5,975	4,339	8,083
特別利益	44	0	44
固定資産売却益	0	0	0
その他	44	-	44
特別損失	765	774	1,201
固定資産除売却損	63	34	340
投資有価証券評価損	111	-	111
関係会社株式評価損	268	375	268
役員特別功労金	181	-	181
特別退職加算金	100	23	118
減損損失	-	313	-
その他	40	27	180
税引前中間(当期)純利益	5,253	3,565	6,926
法人税、住民税及び事業税	2,576	1,379	2,679
法人税等調整額	△546	△179	△563
中間(当期)純利益	3,224	2,366	4,811
前期繰越利益	10,225	13,688	10,225
自己株式処分差損	-	-	0
中間配当額	-	-	482
中間(当期)未処分利益	13,450	16,054	14,554

DISCO Information

会社情報および株式の状況

■ 会社概要

社名	株式会社ディスコ DISCO CORPORATION
本店所在地	東京都大田区大森北二丁目13番11号
創業年月日	1937年5月5日
設立年月日	1940年3月2日
資本金	9,885百万円(2005年9月末日現在)
従業員数	1,261名(2005年9月末日現在)
主な事業内容	精密加工装置 ・製造および販売 ・メンテナンスサービス ・オペレーションやメンテナンスの研修サービス ・解体リサイクル事業 精密加工ツール ・製造および販売 精密部品の有償加工サービス
事業所	本社・R&Dセンター 広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場)
国内拠点	大阪支店、九州支店、仙台営業所、名古屋営業所、諏訪営業所

■ ディスコグループ関連会社

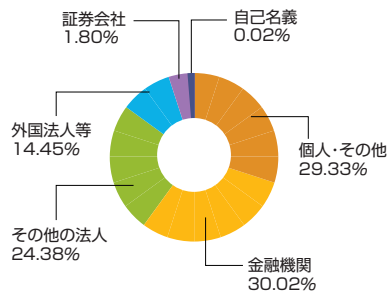
国内法人	株式会社テクニスコ 株式会社ディスコ アプレイシブ システムズ 株式会社ディーエスティー 株式会社ディーエスディー九州
海外法人	DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U.K. LTD. DISCO HI-TEC MOROCCO SARL DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. JETSIS INTERNATIONAL PTE LTD DD Diamond Corporation S.E.A. Utensili Diamantati S.p.A. DISCO-SEA AMERICA, INC

■ 役員

代表取締役会長…関家 憲一
代表取締役社長…溝呂木 斉
常務取締役……関家 圭三
常務取締役……関家 一馬
取締役……関家 英之
取締役……梶山 啓一
取締役……溝呂木 隆夫
取締役……田村 隆夫
常勤監査役……玉利 晋
常勤監査役……古川 深志
監査役……浅海 芳久
監査役……木谷 孟

■ 所有者別株式数分布状況

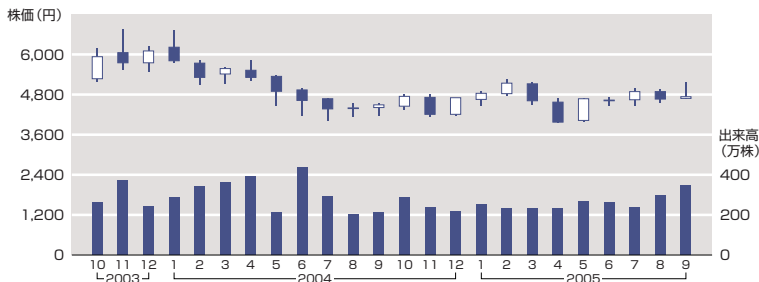
(2005年9月末日現在)



■ 株式概要 (2005年9月末日現在)

上場証券取引所	東京証券取引所第一部上場(証券コード6146)
発行済株式総数	32,180,240株
株主数	14,834名
大株主	日本マスタートラスト信託銀行株式会社: 3,243千株 / 10.07% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社: 2,287千株 / 7.10% 株式会社ダイイチ企業: 1,998千株 / 6.20% 株式会社ダイイチホールディングス: 1,998千株 / 6.20% 株式会社OCTAGON LAB: 1,709千株 / 5.31% 関家 臣二: 1,421千株 / 4.41% 関家 憲一: 1,041千株 / 3.23% 株式会社オレンジコーラル: 846千株 / 2.62% 資産管理サービス信託銀行株式会社: 841千株 / 2.61% 日本生命保険相互会社: 809千株 / 2.51%

■ 株式チャート



DISCO Story..... ①

【全6回シリーズ】

砥石から万年筆のペン先に見た未来 起業の原点に 「ものづくりへの情熱」あり。

パッション



1937年(昭和12年)、広島県呉市。軍艦や兵器の開発を行う呉海軍工廠の周辺には、工業用砥石のメーカーがひしめいていました。満州から故郷へ帰ってきた関家三男はこれに目をつけ「第一製砥所」を設立します。しかし後発メーカーである第一製砥所にとって、海軍工廠からの受注は思うようにはいかず、営業へ出た大阪では厳しい値下げ要求の連続。「これではやっていけない」そう思った三男は、東京神田に事務所を構え、たった一人で民間企業への売り込みを始めました。創業4年目、最初の転機でした。



創業当時の第一製砥所(呉市)

第二の転機は、1941年、東京進出の翌年に訪れました。小物の研削・研磨用砥石を製造する会社を買収したのです。この買収を弾みに、精密砥石に力を入れるようになり、新製法のレジノイド砥石の製造に成功。この製法は、砥石を薄くでき、精密切断加工を可能にするものでした。

戦後復興期。開発した1.2ミリメートル厚の高精度レジノイド砥石は、住宅ブームの後押しもあり、家庭用の積算電力計に内蔵された磁石の先端を研削する用途で広く使われました。この実績を買われ、1956年には大手万年筆メーカーのリクエストで万年筆のペン先を切り割るための厚さ0.14ミリメートルの極薄砥石を開発。100%のシェアを獲得したのです。万年筆用に開発した極薄砥石は、その後、0.1ミリメートルまで薄くなり、電子部品加工に用途が拡大していきました。

そして、1967年、ひとりの営業マンが次の転機をもたらします。「万年筆ペン先砥石の半分の70マイクロメートル(0.07ミリメートル)の砥石を作れば、半導体の切断に使用できる」という情報を得たのです。一年後、ついに、厚さ40マイクロメートルの超極薄レジノイド切断砥石「ミクロンカット」の開発に成功。半導体の世界と社業の未来に向けて高々と帆を揚げたのです。

株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月
利益配当金 受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年9月30日
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日とします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
名義書換代理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(同送付先)	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711 (フリーダイヤル)
同取次所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国本支店
公告掲載新聞	日本経済新聞 (ただし、決算公告につきましては当社のホームページに掲載しております。)
証券コード	6146

“Cutting Edge”とは...

Cutting Edgeとは、辞書で引くと「刃の先端」という意味のほかに、「最先端」という意味があります。ディスコグループの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」という企業ミッションをより深くご理解いただくために、常に最先端の技術を保有しながらも、社会に積極的に貢献していきたいという願いをこのタイトルに込めました。

これからも、ディスコグループの最先端の技術情報とともに、報告内容を充実してまいりますので、どうぞよろしくお願いたします。

さらに詳細な IR情報は こちらからどうぞ。

当社では、株主や投資家の皆様向けにIRサイトを設けております。株価や株式に関するお手続きなどのお知らせのほか、IR関連のお知らせを最新のものから過去5年にさかのぼって検索できる「IRニュース」や株主総会などのスケジュールを掲載した「IRカレンダー」などコンテンツを充実させております。どうぞお気軽にアクセスしてみてください。



<http://www.disco.co.jp/>



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies

株式会社 ディスコ

143-8580 東京都大田区大森北 2-13-11
<http://www.disco.co.jp/>



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しております。



環境に優しい植物性大豆油インキを使用しております。